

Informations de base	
<p>2018/2947(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué</p> <p>Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée</p> <p>Complétant 2008/0240(COD)</p> <p>Subject</p> <p>3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)</p>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Evénements clés			
Date	Evénement	Référence	Résumé
16/11/2018	Publication du document de base non-législatif	C(2018)07499	
16/11/2018	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2.0 mois		
28/11/2018	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
24/01/2019	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		